

2009 年度版日本実装技術ロードマップ「プリント配線板技術編」 目次

序文

第1章 総則

- 1.1 プリント配線板
- 1.2 ロードマップの策定方法
- 1.3 我が国プリント配線板の概況
- 1.4 関連する技術ロードマップ
- 1.5 ロードマップ策定委員

第2章 リジットプリント配線板

- 2.1 ビルドアップ多層配線板
- 2.2 多層プリント配線板
- 2.3 両面プリント配線板
- 2.4 片面プリント配線板

第3章 フレキシブルプリント配線板

- 3.1 フレキシブルプリント配線板の概要
- 3.2 多層フレキシブルプリント配線板
- 3.3 両面フレキシブルプリント配線板
- 3.4 片面フレキシブルプリント配線板

第4章 TAB/COF

- 4.1 TAB
- 4.2 COF

第5章 半導体パッケージ用サブストレート

- 5.1 サブストレートの種類
- 5.2 テープ構造サブストレート
- 5.3 リジット構造サブストレート
- 5.4 ビルドアップ構造サブストレート
- 5.5 セラミック構造サブストレート

第6章 共通事項

- 6.1 表面処理
- 6.2 検査
- 6.3 信頼性

第7章 ディフィカルトチャレンジ

- 7.1 はじめに

- 7.2 微細化技術
- 7.3 穴径微細化
- 7.4 部品内蔵技術

## 第8章 差異分析 (Gap Analysis)

- 8.1 2009年度版日本実装技術ロードマップとの差異分析
- 8.2 IPC2006 - 2007 ロードマップとの比較
- 8.3 iNEMI ロードマップとの差異分析

## Appendix-1 日本実装技術ロードマップで採用されている用語

- 1.1 用語の定義
- 1.2 日本実装技術ロードマップ PWB 技術編関連英文略号一覧

## Appendix-2 JPCA 規格 部品内蔵電子回路基板規格 JPCA-EB01 抜粋

- 1. はじめに
- 2. 適用範囲
- 3. 定義
- 4. 試験方法